

中国武漢市三選科技有限公司および 同社製品を販売する台湾販売代理店 2 社に対する チップ裏面保護テープの特許権侵害訴訟を提起

2026年9月17日、リンテックは、中国を拠点とするチップ裏面保護テープのメーカーである武漢市三選科技有限公司(以下、「三選科技社」という)並びに同社製品を販売している台湾の販売代理店である熱力應用材料有限公司および研展科技股份有限公司をそれぞれ相手方とする特許権侵害に基づく製造および販売等の差止めを求める訴訟(以下、「本件訴訟」という)を、台湾新北市の智慧財産及商業法院(知的財産商業裁判所)に提起いたしました。

当社は三選科技社が製造するチップ裏面保護テープが、当社が保有するチップ裏面保護テープに関する台湾特許第I516530号、第I634187号、第I833953号、第I542659号の特許権(以下、「本件特許」という)を侵害するものと判断し、本件訴訟を提起するに至りました。

本件特許は、Wafer Level Chip Scale Package (WLCSPP) に用いられている重要な技術に関するものであり、当社は、チップ裏面保護テープに関する特許を、2026年6月時点で台湾、中国、韓国、フィリピン、シンガポールを含む8つの国と地域で延べ600件以上保有しております。本件訴訟における三選科技社の被疑侵害製品は以下のとおりです。

- ・CTB-EV6
- ・CTB-EV6X2
- ・CWB-SEHW
- ・CTD-EK1225
- ・CTD-EK0825
- ・CTB-EV6R-HT

当社は、顧客のニーズに応える独創的な製品の開発を通じて企業価値の向上に努めており、知的財産権を重要な経営資源として位置づけています。以下の方針に基づき、知的財産活動を推進しており、本件訴訟もその活動の一環です。

- ・基盤事業領域および成長事業領域における特許ポートフォリオの構築
- ・他社知的財産権の尊重
- ・当社の知的財産権を侵害する第三者への権利行使を含む適正な措置

当社は、本件訴訟の進展を注視しながら、必要に応じて他の特許権侵害に対する訴訟を提起する等さらなる権利行使についても検討してまいります。

■リリース内容に関する報道関係者の方からのお問い合わせ

リンテック株式会社 広報・IR 室

〒173-0001 東京都板橋区本町 23-23 TEL. (03)5248-7741 FAX. (03)5248-7754 担当:阿部、高津

<https://www.lintec.co.jp/>